

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Art Unit	:		Customer No.: 035811
Examiner	:		
Serial No.	:		
Filed	:	Herewith	
Inventors	:	Stefan Fürst	Docket No.: 1399-03
	:	Michael Moser	
	:	Heinrich Stelzig	Confirmation No.:
	:	Claudia Rathmann	
	:	Dr. Fatima Birke-Salam	
	:	Dr. Dejan Ilic	
	:	Ulrich Bosch	
	:	Dr. Thomas Woehrle	
Title	:	THIN ELECTRONIC CHIP CARD AND	
	:	METHOD OF MAKING SAME	Dated: January 28, 2004


CLAIM FOR PRIORITY UNDER 35 U.S.C. §119

Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

Sir:

We submit herewith the certified copy of German Patent Application No. DE 103 04 824.3,
filed January 31, 2003, the priority of which is hereby claimed.

Respectfully submitted,


T. Daniel Christenbury
Reg. No. 31,750
Attorney for Applicants

TDC:lh
(215) 656-3381

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND



Prioritätsbescheinigung über die Einreichung einer Patentanmeldung

Aktenzeichen: 103 04 824.3

Anmeldetag: 31. Januar 2003

Anmelder/Inhaber: VARTA Microbattery GmbH, Hannover/DE

Bezeichnung: Dünne elektronische Chipkarte

IPC: G 06 K 19/00

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

München, den 15. Oktober 2003
Deutsches Patent- und Markenamt

Der Präsident

Im Auftrag

Faust

Anmelderin: VARTA Microbattery GmbH
Am Leineufer 51

30419 Hannover

Unser Zeichen: P 42 655 DE

31. Januar 2003
TM/nw

Beschreibung

Dünne elektronische Chipkarte

Gegenstand der Erfindung ist eine dünne elektronische Chipkarte mit einem IC-Chip und einem galvanischen Element als Energiespeicher, welches mindestens eine lithiuminterkalierende Elektrode besitzt und ein dünnes, flexibles Gehäuse aus zwei Metallfolien, die direkt an den Elektroden anliegen und die miteinander über eine Klebe- oder Siegelschicht dicht verbunden sind, aufweist.

Als Energiespeicher in „Active Smart Cards“ sind extrem dünne, flexible galvanische Elemente mit einer Gesamtdicke von beispielsweise weniger als 0,5 mm erforderlich. Bei solchen dünnen elektronischen Chipkarten ist der flache Energiespeicher zur Stromversorgung des IC-Chips oder anderer Bauelemente wie integrierter Miniatursensoren oder Transponder vorgesehen.

Eine derartige Smart - Card muss in ihrer Gesamteigenschaft bestehend aus Kartenkörper, Bauelementen und Energiespeicher ISO-konform nach ISO - Biegefest DIN - ISO7816 - 1 und DIN ISO / IEC 10373 sein, d.h. der ISO Biegetest nach DIN - ISO 7816-1 und die Prüfvorschrift

nach DIN ISO/IEC 10373 muss erfüllt werden. Beim dynamischen Biegetest wird die Karte mit einer Frequenz von 30 Biegungen pro Minute ($= 0,5 \text{ Hz}$) 2 cm in der Länge bzw. 1 cm in der Breite gewölbt. Eine Karte muss bei diesem Test mindestens 250 Biegungen in jede der vier möglichen Richtungen (insgesamt also 1000 Biegungen) ohne Schäden überstehen. Beim dynamischen Torsionstest wird die Karte $\pm 15^\circ$ um die Längsachse mit einer Frequenz von 30 Biegungen pro Minute ($= 0,5 \text{ Hz}$) belastet. Der Standard verlangt 1000 Torsionen, ohne dass die Chipfunktionalität ausfällt oder mechanische Schäden an der Karte sichtbar werden.

Bei den bisher eingesetzten Heiss- und Kaltlaminationsverfahren wurde das Metallgehäuse des Elements häufig beschädigt, so dass das Gesamtsystem Karte unbrauchbar wurde. Wenn das Gehäuse mit bekannten Klebern, wie beispielsweise gängige zweikomponentige Polyurethanklebstoffe durch Kaltlamination in die Chipkarte eingebracht wurde, traten häufig Risse bei der Durchführung der ISO – Biegetests auf.

Das Dokument EP 0 997 959 B1 beschreibt galvanische Elemente mit einem nichtwässrigen Elektrolyten, die Gehäuse aus Laminatfilmen besitzen. Derartige Lamine bestehen in der Regel aus einer doppelseitig beschichteten Aluminiumverbundfolie, die sich leicht bis zu 5 mm tiefziehen lässt und den ISO-Test aufgrund dieser Eigenschaft sofort besteht. Die Kunststoffummantelung verhindert dabei ein Einreißen.

In der Patentanmeldung DE 101 02 125.9 ist die mechanische Verstärkung einer elektronischen Chip-Karte mit darin angeordnetem galvanischen Element mittels einer aus Metall oder faserverstärktem Kunststoff bestehenden Teil-/ oder Ganzüberdeckung beschrieben.

Eine weitere Möglichkeit zur Stabilisierung des Metallgehäuses ist in der deutschen Patentanmeldung 102 26 848.7 vorgeschlagen. Dabei ist bei

einem galvanischen Element mit mindestens einer lithiuminterkalierenden Elektrode und einem dünnen, flexiblen Gehäuse aus zwei Metallfolien, die direkt an den Elektroden anliegen und die miteinander über eine Klebe- oder Siegelschicht dicht verbunden sind, mindestens eine der Metallfolien auf der Außenseite mit einer die Stabilität und Festigkeit erhöhenden Kunststoffschicht versehen und zwischen Metallfolie und Kunststoffschicht ist eine Adhäsionsschicht angeordnet.

Ein solches galvanisches Element muss jedoch in weiteren Verfahrensschritten in einen Folienverbund überführt werden.

Der Erfindung liegt insbesondere die Aufgabe zugrunde, eine aktive Chipkarte anzugeben, welche die hohen Anforderungen an mechanische Stabilität gegenüber Biegebeanspruchungen und Torsionsbeanspruchungen erfüllt und welche einfach herstellbar ist und aus nur wenigen Schichten aufgebaut ist.

Diese Aufgabe wird bei einer Chipkarte der eingangs genannten Gattung durch die kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 gelöst. Den Unteransprüchen sind vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung zu entnehmen.

Erfindungsgemäß erfolgt die Einlamination eines galvanischen Elements mit mindestens einer lithiuminterkalierenden Elektrode und einem dünnen, flexiblen Gehäuse aus zwei Metallfolien, die direkt an den Elektroden anliegen und die miteinander über eine Klebe- oder Siegelschicht dicht verbunden sind, in eine Smartcard bei Umgebungstemperatur mittels eines elastischen Klebers. Eine Smartcard oder Chipkarte ist dabei ein mehrlagiger, biegsamer Kunststoffverbund, der Funktionen, wie beispielsweise Sensorik, Datenspeicherung und -abruf aufweist.

Das galvanische Element ist in einer Ausnehmung der Chipkarte angeordnet und Chipkarte und Element sind beidseitig durch eine Overlay-

Kunststofffolie abgedeckt, die mit Chipkarte und Element über einen elastischen spannungsausgleichenden Kleber, der gleichzeitig auf Metallen und Kunststoffen haftet, fest verbunden ist. Die Overlay-Kunststofffolien sind durch Kaltlamination aufgebracht.

Bei der Heisslamination werden durch Druck und gleichzeitiger Einwirkung von höheren Temperaturen (typischerweise mehr als 100°C) Kunststoff-Schichten flächig miteinander an der Oberfläche verschmolzen; dabei haften die Flächen bleibend aneinander und es entsteht ein Verbund aus den eingesetzten Kunststoff-Folien. Eine energiesparende Alternative zu der Heisslamination ist die sogenannte Kaltlamination. Wie bei der Heisslamination wird Druck auf die übereinandergelagerten Folien ausgeübt; jedoch erfolgt das Vereinigen der zu verklebenden Flächen bei Umgebungstemperatur (Raumtemperatur) oder bei Wärm Temperaturen bis 50°C. Ein erfindungsgemäßer einkomponentiger Kleber ist eine fließfähige, zähflüssige Masse, die das galvanische Element verkapselt, in die Smart-Card einbettet und nach dem Polymerisieren (Aushärten) eine bleibende Flächenhaftung zu den Kartenfolien und der metallischen Gehäuse-Oberfläche des galvanischen Elements bewirkt.

Der Kleber sollte eine Glasübergangstemperatur zwischen 35° C und 70° C und eine Reißdehnung von 40 - 52 % nach DIN ISO 527 besitzen und lichtaushärtend sein. Insbesondere ist der Kleber ein Epoxidharz oder ein thermoplastisches Polyurethan-basiertes Material.

Die Overlay-Kunststofffolie besteht vorzugsweise aus PVC. Alle Flächenhaftungen in der Karte -Overlay- zur Kernfolie, metallische Oberfläche des Gehäuses zur Overlay-Folie und metallisches Gehäuse zur Kernfolie – sind durch Kaltlamination hergestellt.

Durch die erfindungsgemäße Verwendung eines elastischen, also spannungsausgleichenden Klebers verbunden mit einer Aushärtung, die bei

Raumtemperatur stattfindet, kann das Gesamtsystem Smartcard - Kleber - Flachzelle in ein mechanisch stabiles System überführt werden, welches insgesamt auf eine hohe Belastbarkeit während den ISO - Biegetests abgestimmt ist.

Bei der Durchführung der Versuche mit anderen, in der Regel spröderen Klebstoffen, ergab sich eine Ausschußquote von 20 % - 100 %. Bei der Verwendung eines spannungsausgleichenden, lichtaktivierbaren Epoxidharzes mit einer Reißdehnung von ca. 40 % - 52 % nach DIN EN ISO 527 und einer Glasübergangstemperatur von 45° - 49° C trat keine Beschädigung des galvanischen Elements bzw. der Batterie oder der Karte auf.

Die Glasstemperatur bzw. Glasübergangstemperatur (T_g) ist die Temperatur, bei der amorphe oder teilkristalline Polymere vom gummielastischen oder flüssigen Zustand in einen hartelastischen oder glasigen Zustand übergehen oder umgekehrt. Das Phänomen begründet sich auf das Einfrieren oder Auftauen der Brownschen Molekularbewegung längerer Kettensegmente des Polymerknäules. Wird die Glasstemperatur erreicht, werden die physikalischen Eigenschaften stark verändert. Beispiele dafür sind die Viskosität oder die Härte.

Besonders vorteilhaft ist für die Eigenschaft im Biegetest die Tatsache, dass die erfindungsgemäß vorzugsweise verwendeten Epoxidharze, die vorteilhafte Eigenschaften bei den Tests zeigten, eine verhältnismäßig niedrigere Glasstemperatur besitzen, die bei ungefähr 50° C liegt. Somit sind diese gehärteten Epoxidharze elastischer als diejenigen, die eine Glasstemperatur von beispielsweise 140° C aufweisen und somit spröde sind und beim ISO-Biegetest Risse bekommen.

Epoxidharze sind organische, zumeist oligomere Verbindungen, die insbesondere eine Epoxid-Gruppe besitzen und durch Polymerisationsverfahren in sogenannte Duroplaste überführt werden können („Härten“). Der Schwund beim Härteprozess ist gering, die gehärteten Pro-

dukte sind spannungsfrei und reissfest, was von grossem Vorteil für den Biegetest ist. Ferner haften bzw. kleben diese Epoxidharze an metallischen Oberflächen, wie zum Beispiel Kupfer und führen ein für sich betrachtetes mechanisch instabiles, dünnes Kupfer in einen elastischen und stabilen Gesamtverbund Epoxidharz mit Kupfer über.

Eine erfindungsgemäße dünne elektronische Chipkarte mit einem IC-Chip und einem galvanischen Element als Energiespeicher ist schematisch in der Figur dargestellt.

Als Kartenmaterial dient eine Kernfolie 1 aus PVC/ABS-Blend (Dabei sind PVC Polyvinylchlorid, ABS Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer), die in einer Aussparung ein galvanisches Element 3 enthält. Die Overlay-Folie 2 besteht aus PVC.

Ein vorteilhafter Kleber 4 ist ein modifiziertes ein-komponentiges Epoxidharz (beispielsweise das Produkt Katiobond® der Firma DELO, Deutschland). Das Aushärten erfolgt durch Lichtaktivieren mit sichtbarem Licht. Eine herausragende Eigenschaft, die für die Anwendung von galvanischen Elementen mit Kupfergehäuse in der Smartcard von Bedeutung ist, ist die hervorragende Verklebung an metallischen Oberflächen. Die Endfestigkeit wird nach 24 h erreicht.

Epoxidharze haben gute chemische Beständigkeit und sind physiologisch unbedenklich. Diese speziellen Epoxidharze weisen einen geringen Schwund beim Härtingsprozess auf und nach dem Härten entstehen spannungsfreie und reißfeste Kunststoffe; dies ergibt einen erheblichen Vorteil beim Biegetest.

Als alternativer erfindungsgemäßer Kleber kann ein thermoplastischer Polyurethan-basierter Klebstoff, beispielsweise Henkel TPU QR 4663, mit Erfolg verwendet werden.

Zur Herstellung der dünnen elektronischen Chipkarte wird die Kernfolie 1

ausgestanzt, damit das galvanische Element 3 eingelegt werden kann. Dann wird eine dosierte Klebermenge durch ein Rakel vollflächig auf der Kernfolie 1 ausgestrichen; dabei fließt der Kleber 4 auch in einen Hohlraum zwischen Kernfolie 1 und dem galvanischen Element 3. Danach wird die Overlay-Folie 2 aufgelegt, diese Vorstufe für die laminierte Karte gewendet, der Rakelvorgang wiederholt und die zweite Overlay-Folie 2 aufgelegt. Nach dem Verpressen der Karte (ohne Wärmeeinbringung) wird diese belichtet, um den Aushärtevorgang zu initiieren.

Patentansprüche:

1. Dünne elektronische Chipkarte mit einem IC-Chip und einem galvanischen Element als Energiespeicher, welches mindestens eine lithiuminterkalierende Elektrode besitzt und ein dünnes, flexibles Gehäuse aus zwei Metallfolien, die direkt an den Elektroden anliegen und die miteinander über eine Klebe- oder Siegelschicht dicht verbunden sind, aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass das Element in einer Ausnehmung der Chipkarte angeordnet ist und dass Chipkarte und Element beidseitig durch eine Overlay-Kunststoffolie abgedeckt sind, die mit Chipkarte und Element über einen elastischen spannungsausgleichenden Kleber, der gleichzeitig auf Metallen und Kunststoffen haftet, fest verbunden ist.
2. Dünne elektronische Chipkarte nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass alle Flächenhaftungen in der Karte, nämlich Overlay-Folie zur Kernfolie, Oberfläche des metallischen Gehäuses zur Overlay-Folie und metallisches Gehäuse zur Kernfolie, durch Kaltlamination hergestellt sind.
3. Dünne elektronische Chipkarte nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Kleber eine Glasübergangstemperatur zwischen 35° C und 70° C hat und eine Reißdehnung von 40 - 52 % nach DIN ISO 527 besitzt.
4. Dünne elektronische Chipkarte nach einem der Ansprüche 1-3, dadurch gekennzeichnet, dass der Kleber lichtaushärtend ist.
5. Dünne elektronische Chipkarte nach einem der Ansprüche 1-4, dadurch gekennzeichnet, dass der Kleber ein Epoxidharz ist.

6. Dünne elektronische Chipkarte nach einem der Ansprüche 1-4, dadurch gekennzeichnet, dass der Kleber ein thermoplastisches Polyurethan-basiertes Material ist.
7. Dünne elektronische Chipkarte nach einem der Ansprüche 1-6, dadurch gekennzeichnet, dass die Overlay-Kunststoffolie aus PVC besteht.

Zusammenfassung

Bei einer dünnen elektronischen Chipkarte mit einem IC-Chip und einem galvanischen Element als Energiespeicher, welches mindestens eine lithiuminterkalierende Elektrode besitzt und ein dünnes, flexibles Gehäuse aus zwei Metallfolien, die direkt an den Elektroden anliegen und die miteinander über eine Klebe- oder Siegelschicht dicht verbunden sind, aufweist, ist das Element in einer Ausnehmung der Chipkarte angeordnet und Chipkarte und Element sind beidseitig durch eine Overlay-Kunststoffolie abgedeckt, die mit Chipkarte und Element über einen elastischen spannungsausgleichenden Kleber, der gleichzeitig auf Metallen und Kunststoffen haftet, fest verbunden ist.

Alle Flächenhaftungen in der Karte, nämlich Overlay- zur Kernfolie, metallische Oberfläche des Gehäuses zur Overlay-Folie und metallisches Gehäuse zur Kernfolie, sind durch Kaltlamination hergestellt. Als Kleber wird ein Epoxidharz oder ein thermoplastisches Polyurethan-basiertes Material verwendet.

Veröffentlichung mit Figur

